

北京兆易创新科技股份有限公司 关于拟签署战略合作协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 经公司审慎判断，本协议的相关内容涉及商业秘密，履行公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》规定的审核程序后豁免披露，公司只在允许的范围内披露相关信息。

为保障双方长期稳定合作，北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与国内某大型集成电路芯片代工企业（以下称“代工厂”）签署《战略合作协议》，有关具体情况公告如下：

一、审议程序情况

2017年9月5日，公司召开第二届董事会第18次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了公司《关于拟签署<战略合作协议>的议案》。该协议为公司日常经营相关协议，无需提交股东大会审议。

二、对方当事人情况

因本协议涉及保守商业秘密，根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》等相关规定，经履行公司内部审核程序，豁免披露交易对手方基本情况及与交易对手方发生类似交易情况。

此次交易对手方与公司不存在关联关系。

公司与该交易对手方长期以来一直保持着持续、良好的合作关系。交易对手方信用优良，具备良好的履约能力。

三、合同主要条款

- 1、合同类型：供货合作协议。
- 2、合同标的：原材料晶圆。
- 3、合同金额：至 2018 年底采购金额为 12 亿元人民币或以上。
- 4、合同生效条件和时间：经双方签署后生效。
- 5、其他：协议条款中对于违约责任、保密、争端解决等事项作出了规定。

四、协议履行对上市公司的影响

1、本协议有利于保障公司长期稳定的产能供应，协议履行对公司 2017 年的财务状况和经营业绩不构成重大影响，对公司 2018 年及以后的财务状况和经营业绩影响情况尚无法判断。

2、本协议的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行协议而对当事人形成依赖。

3、协议双方维持了多年的良好合作，本协议将进一步巩固双方的长期合作伙伴关系、增强公司竞争优势。

五、协议履行的风险分析

1、战略合作协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，具体合作事宜需在订单中明确，后续的具体履行存在不确定性。

2、协议主体具有履约能力，但在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响合同履行。

公司将根据具体合作事项进展情况，按照有关要求及时披露后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2017年9月5日